



苏州华芯微电子股份有限公司

SUZHOU HUAXIN MICRO-ELECTRONICS CO.LTD. www.h-sun.com

迷你烧录器使用说明书

Ver1.2



目录

一. 概述.....	2
二. 安装驱动.....	3
三. 固件更新流程.....	4
更新方式 1：自动更新.....	4
更新方式 2：手动更新.....	6
更新方式 3：强制更新.....	9
四. 烧录流程.....	12
五. 烧录方式.....	17
1、硬件方式.....	17
2、软件方式.....	17
六. 迷你机台烧录器与机台连接方式.....	18
七. 迷你机台烧录器芯片放置方式.....	20
1、转接卡外观说明：.....	20
2、芯片放置说明：.....	21
HS2300-P 不同封装脚位放置说明：.....	21
HS26P10 不同封装脚位放置说明：.....	23
附录：补充说明.....	25
迷你机台烧录器：.....	25
6620 系列烧录器相关说明：.....	25



HSUN-Writer

使用说明书

Ver1.2

一. 概述

该烧录器目前支持烧录华芯微公司以下芯片进行烧录：

1 系列 (HS2300-P, HS2300-PE, HS23P1800, HS23P10, HS26P10, HS26P10E, HS23P3022, HS23P2710, HS23P2711, HS23P2720, HS23P2721)；

2 系列 (HS23F2211, HS23F1311, HS23F2221, HS23F2251, HS23F3251, HS16F3211, HS16F3311)；

3 系列 (HS23P6601, HS23P6602, HS23P6610, HS23P6631, HS23P6625, HS23P6635)；

6 系列 (HS26F1328, HS26F2728, HS26F36)；

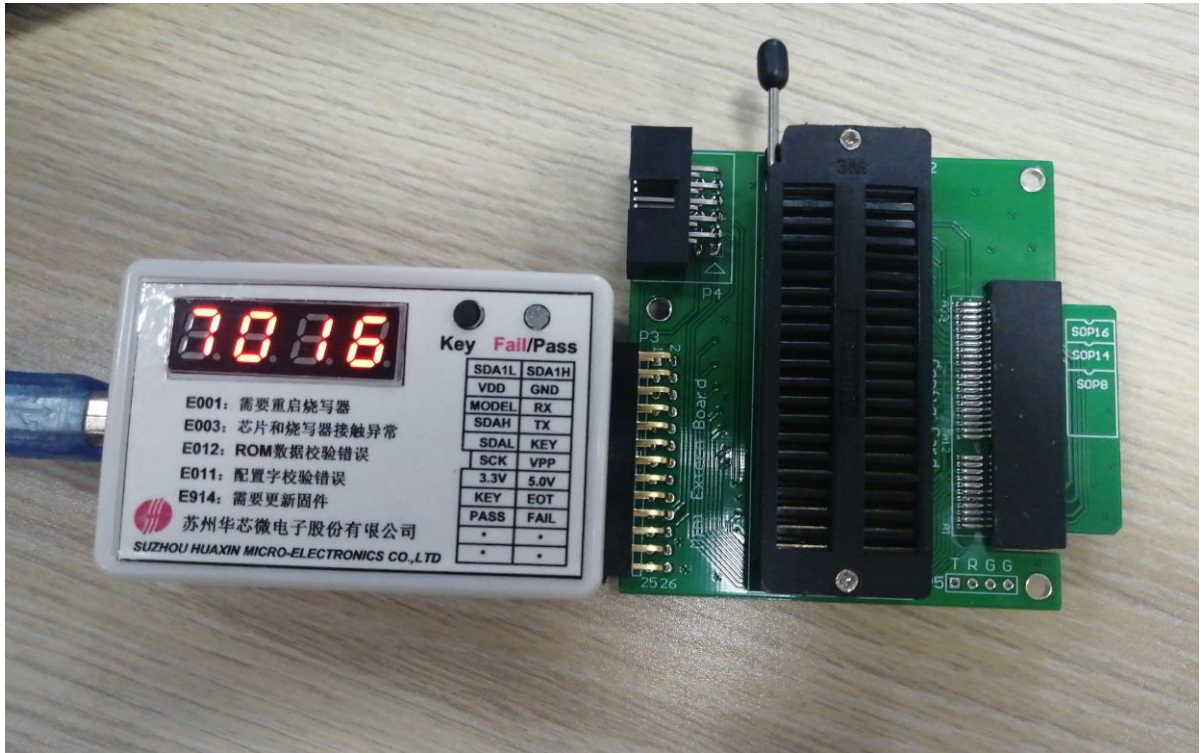
7 系列 (HS32F0033)。



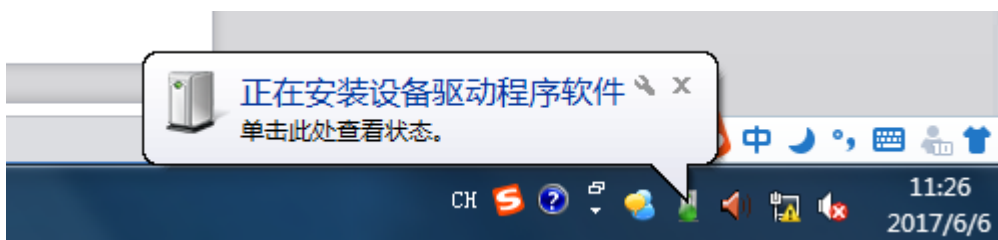
二. 安装驱动

安装驱动应注意：没有驱动包，但首次使用也需要等待系统安装

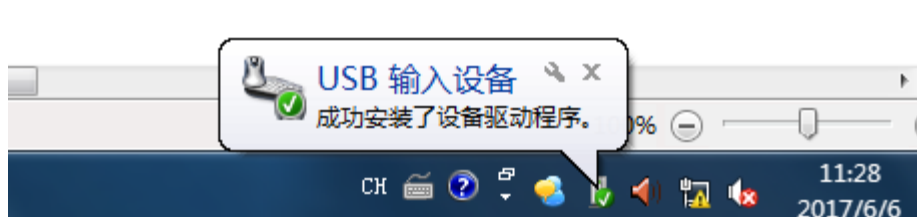
(1) 将烧写器插入 USB 线：



(2) 等待电脑桌面右下角出现如下界面，提示安装驱动程序：

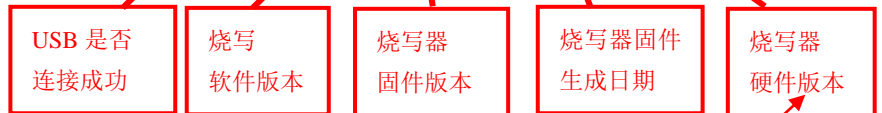
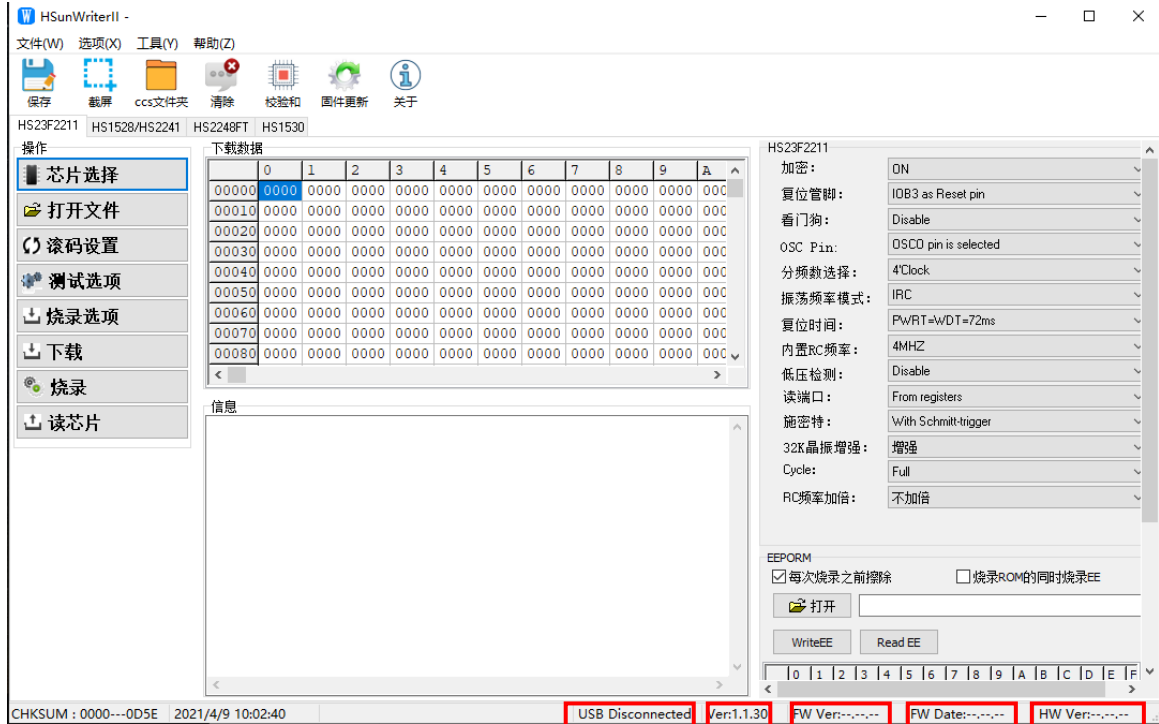


(3) 直到电脑提示已经成功安装驱动程序之后，您就可以正常使用烧录器了。



三. 固件更新流程

首先对上位机软件界面进行介绍，方便使用者对固件进行选择。



USB Connected	连接成功
USB Disconnected	连接失败

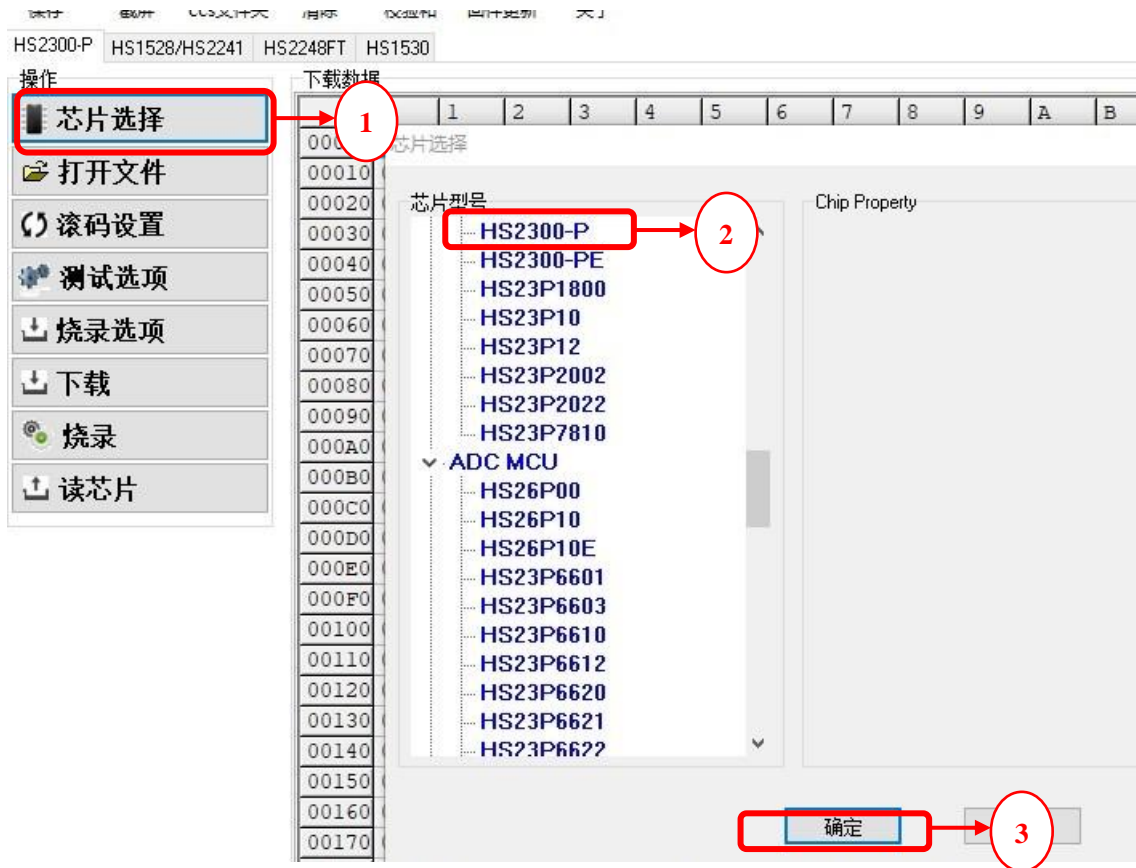
判断固件选择 305 还是 500，以此为淮

更新方式 1：自动更新

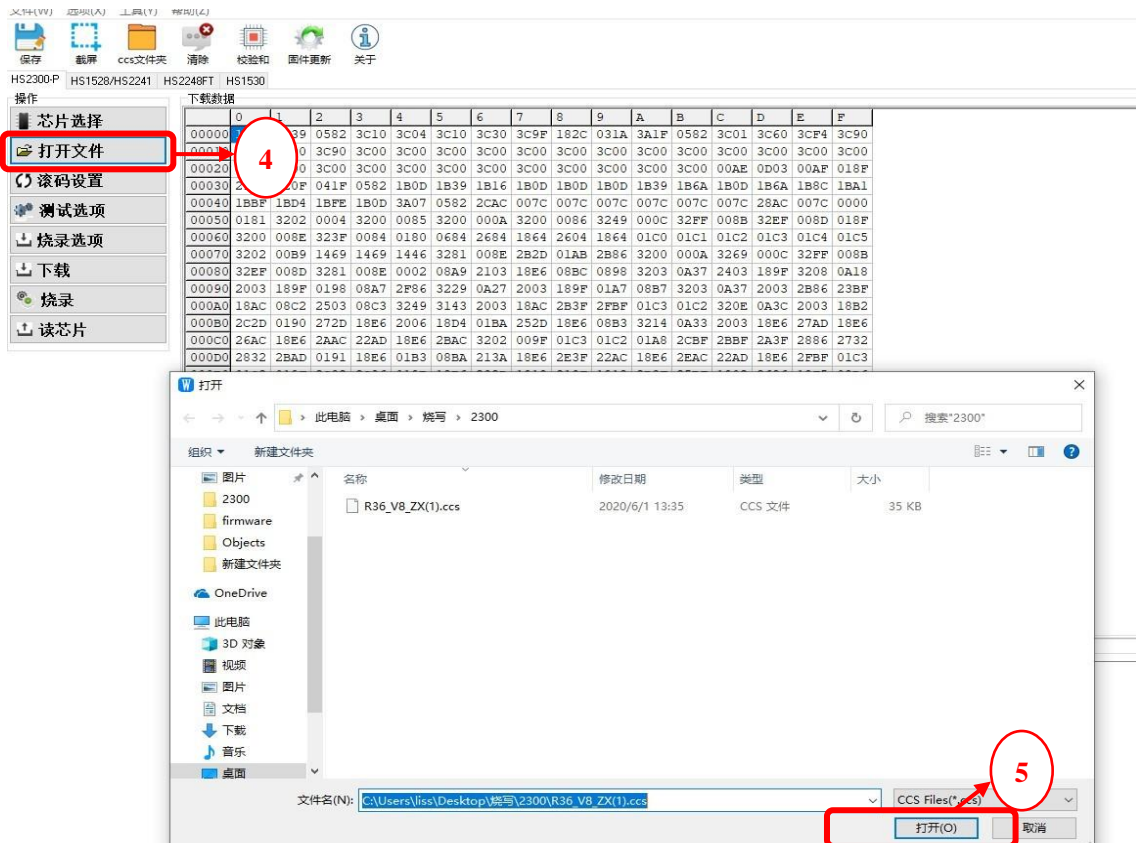
使用 33 及以上版本上位机软件，可实现最新固件自动更新。下图示例中使用芯片为 HS2300-P。

第 1 步：插入 USB 线。

第 2 步：选择准备烧录的芯片型号。



第 3 步：选择想要烧录的程序 ccs 文件。





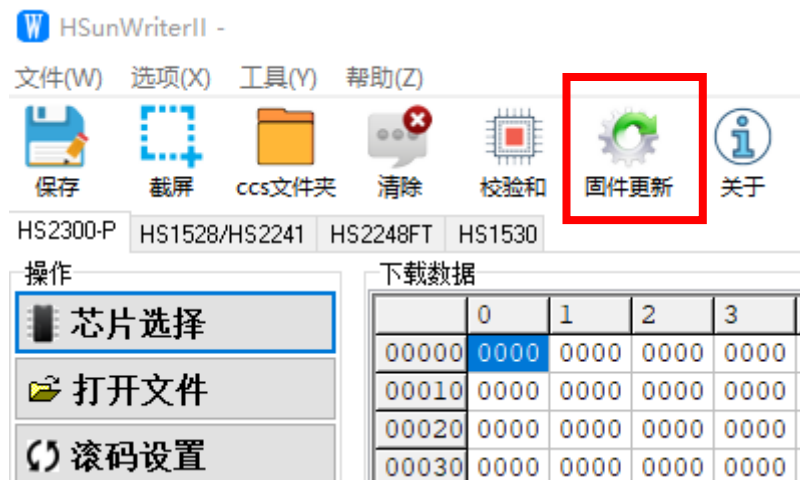
第 4 步：点击下载，可自动进行固件的更新与切换。



更新方式 2：手动更新

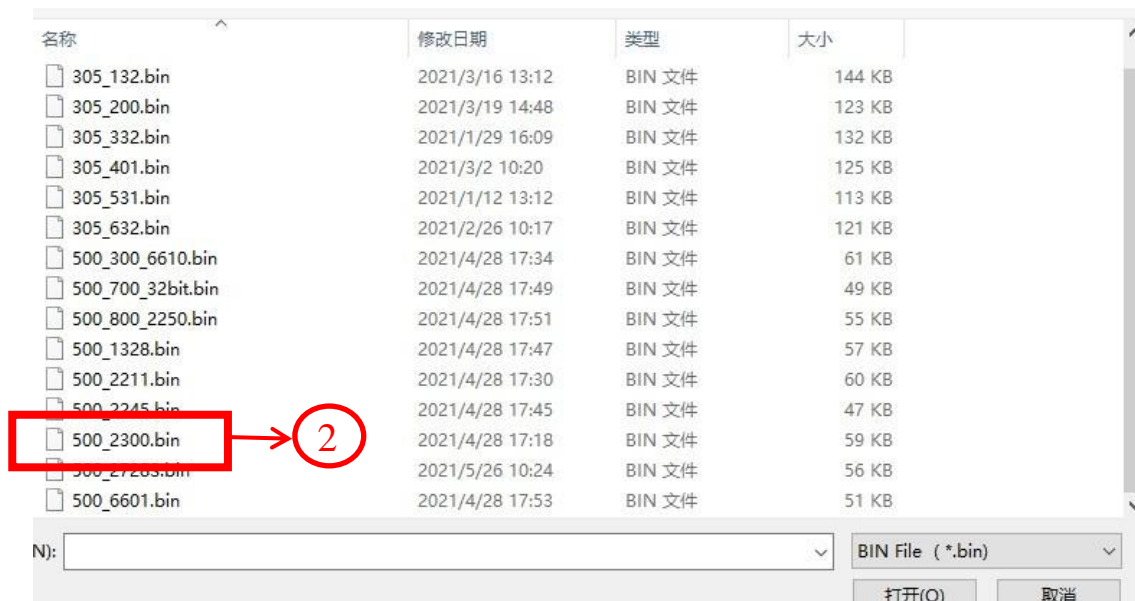
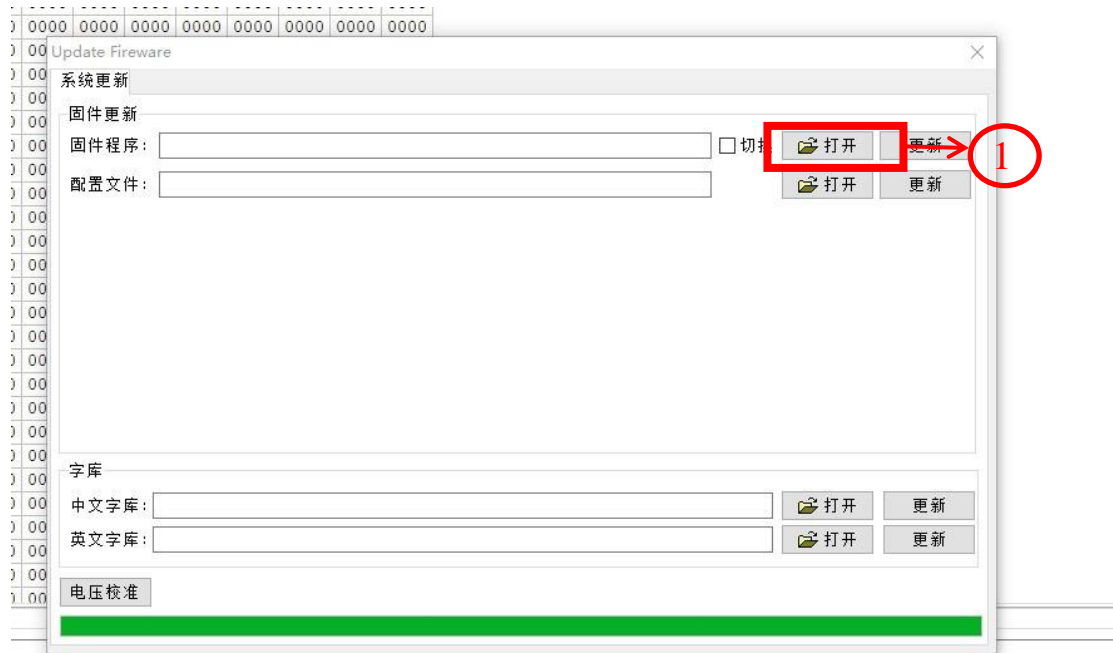
第 1 步：插入 USB 线。

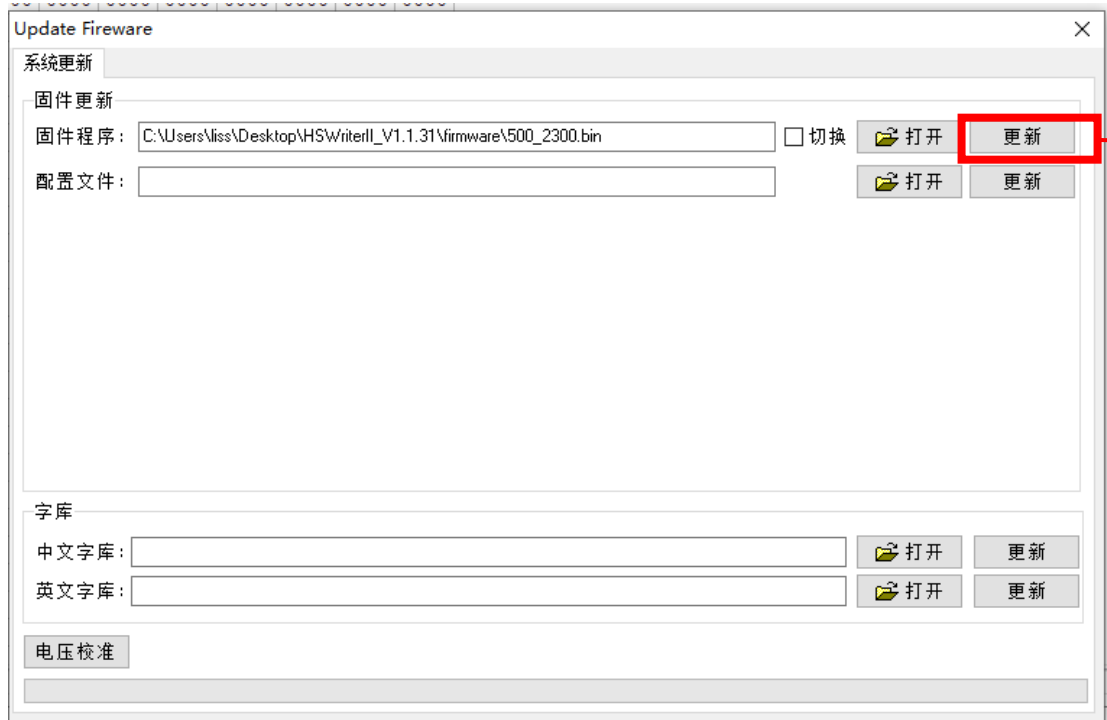
第 2 步：打开上位机烧录软件，点击“固件更新”按钮。



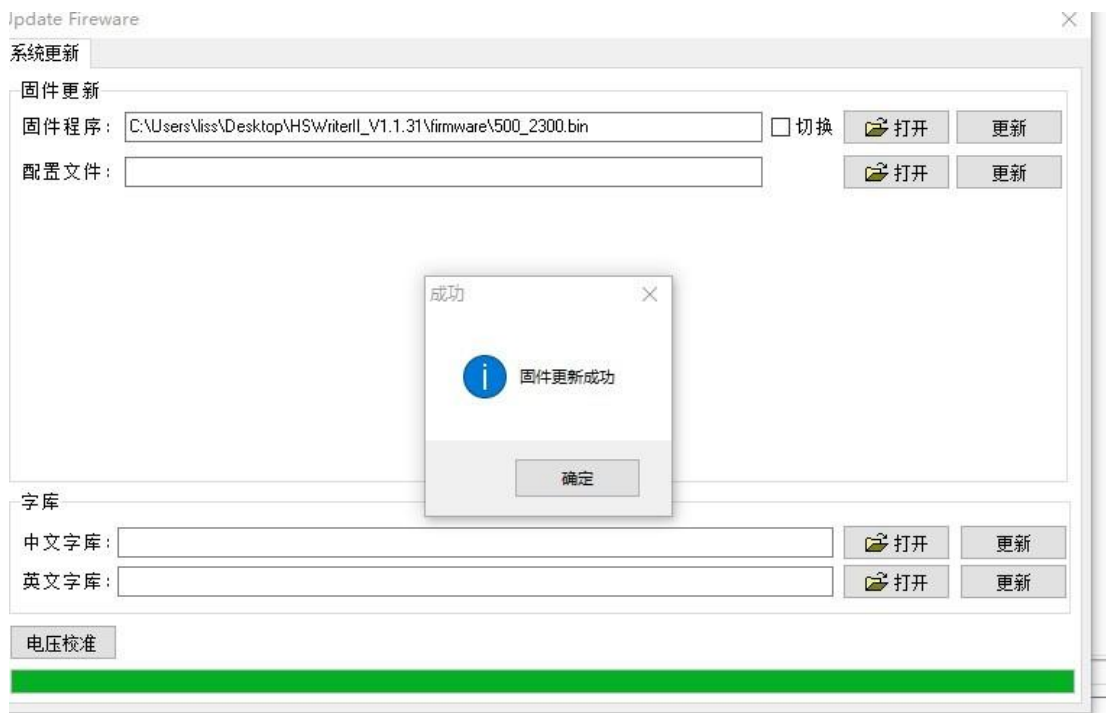


第 3 步：选择 500 系列固件进行更新，示例中选用 500-2300. bin 进行固件更新。





第 4 步：更新成功后将出现下图提示。



第 5 步：等待数据拷贝完成(5 秒左右)。

更新方式 3：强制更新

第 1 步：将烧录器断电，并在重新上电之前长按 KEY 键（下图红色框所圈位置）。



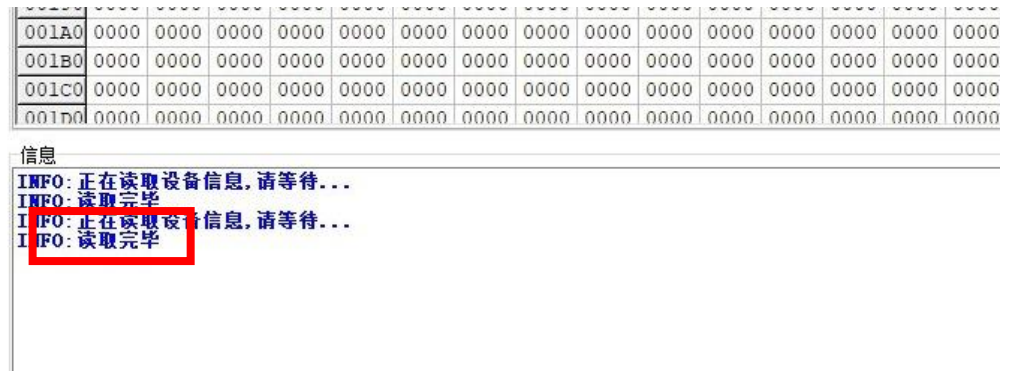
第 2 步：上电之后保持按压状态，需注意断电到上电过程均要保持按压状态，持续 5-10 秒，直

至烧录器显示屏显示如下。

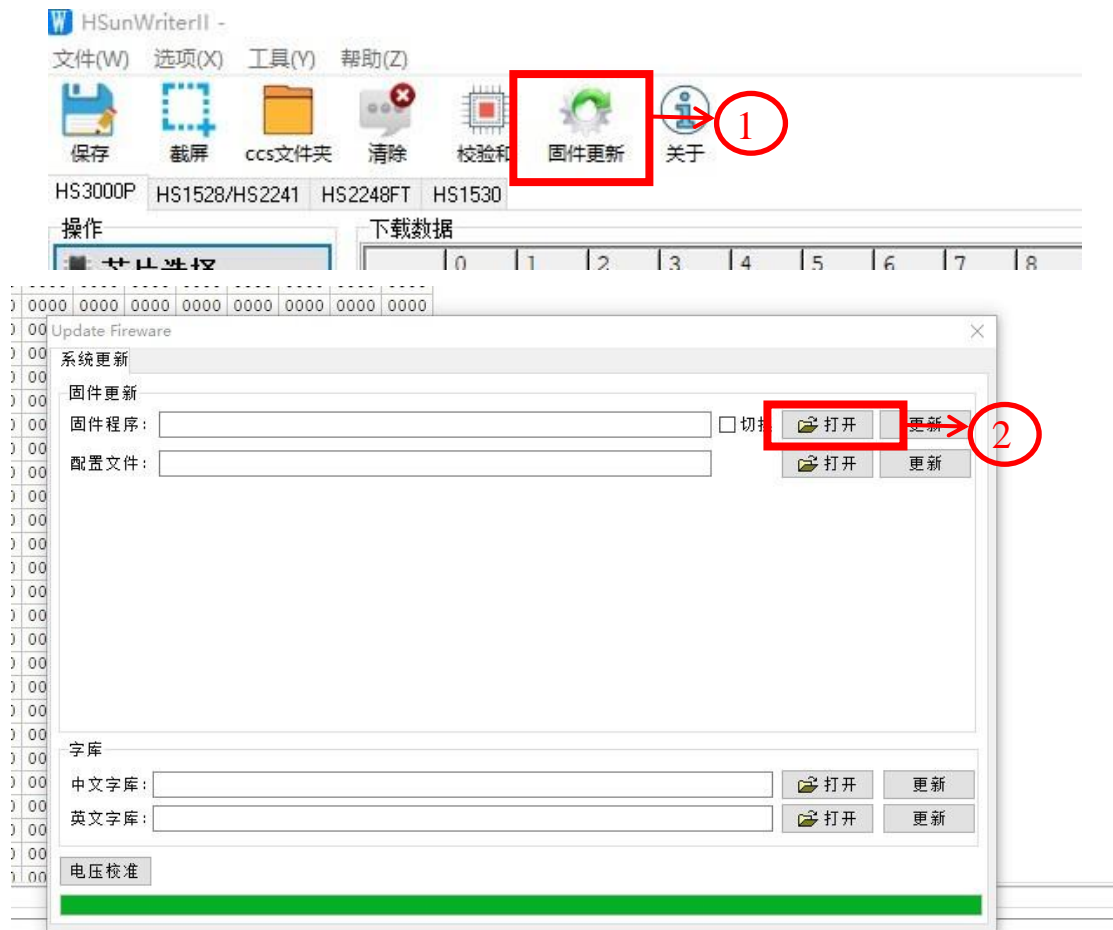


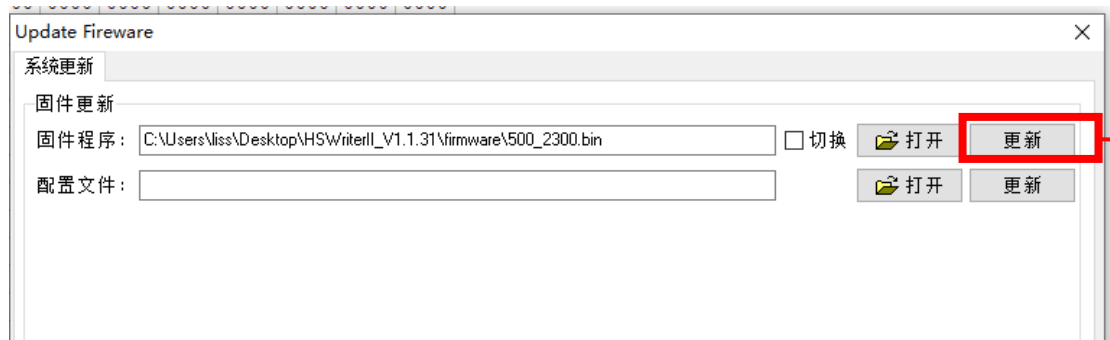
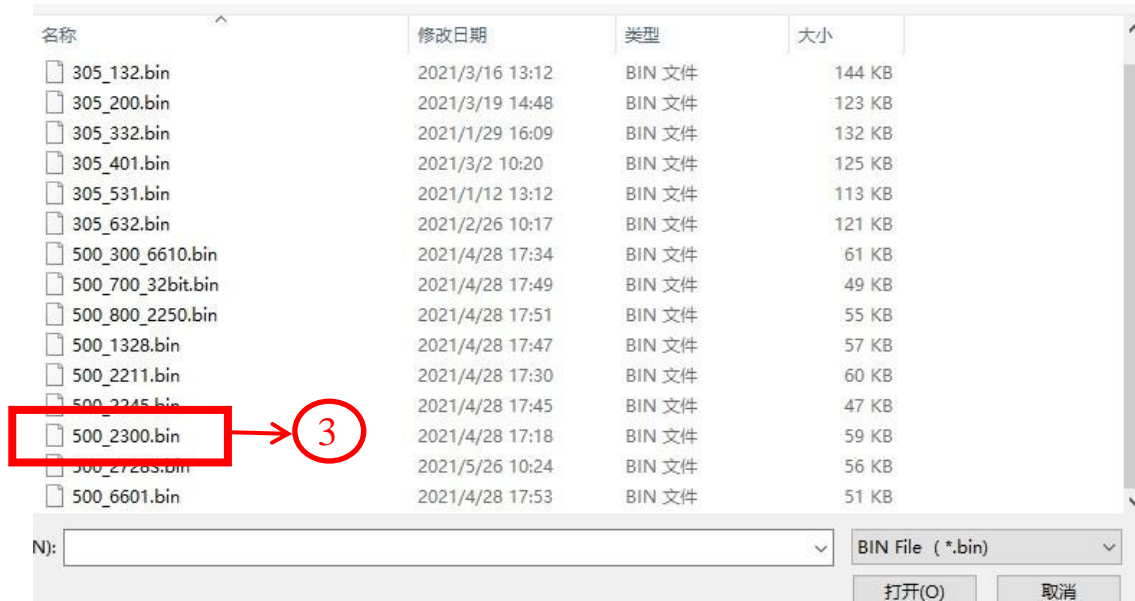


第 3 步：此时上位机软件显示区会提示 设备已读取完毕。

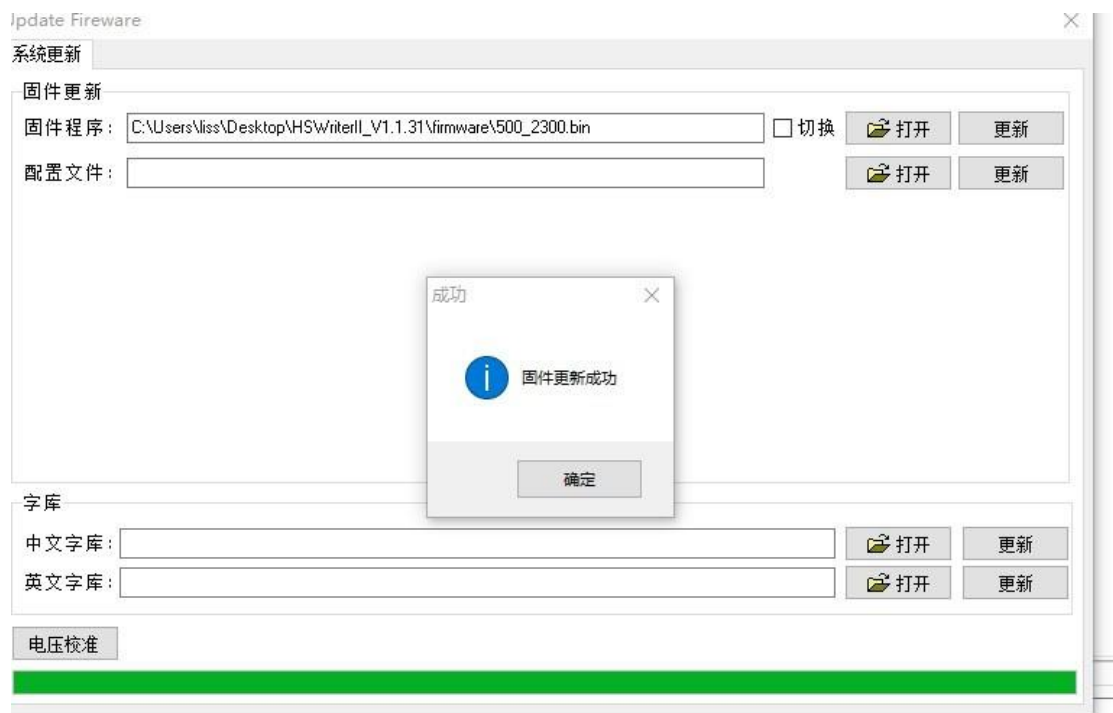


第 4 步：进行固件更新。点击工具栏内的固件更新选项，选择 500 系列固件进行更新，示例中选用 500-2300. bin 进行固件更新。





第 5 步：更新成功后将出现下图提示。

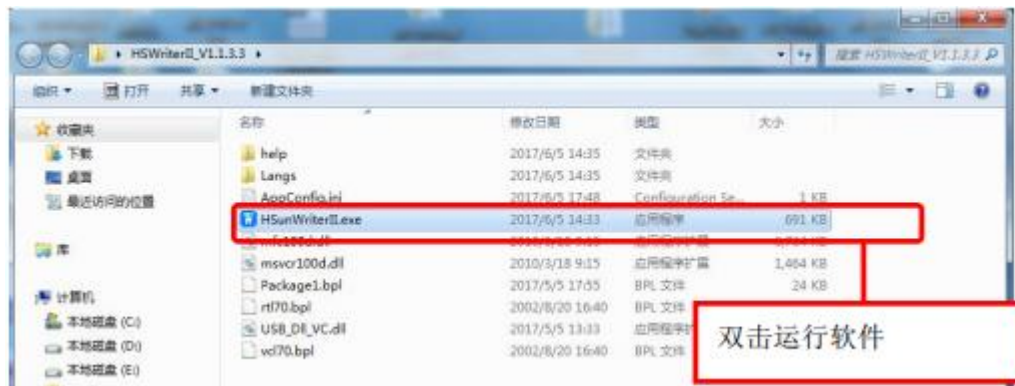


四. 烧录流程

第 1 步：将 USB 线与迷你机台烧录器连接。

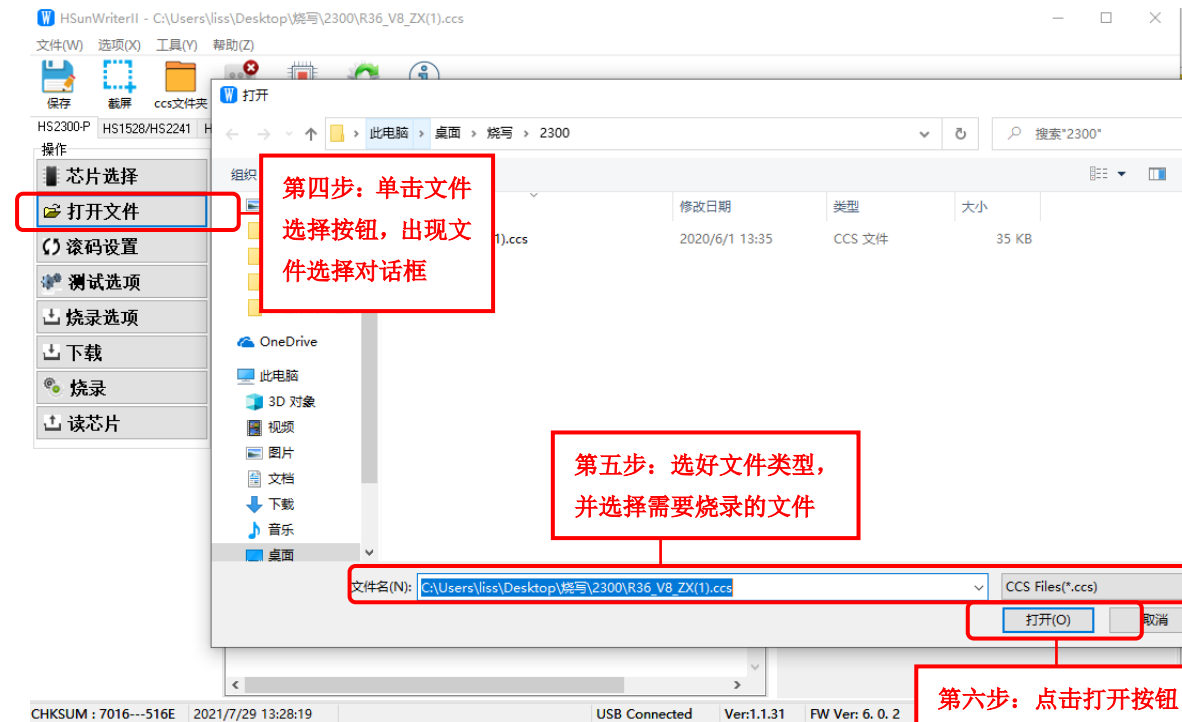


第 2 步：按以下方式下载烧录文件，注意下载完成 CCS 文件后迷你机台烧录器会重新初始化
双击 HSunWriterII.exe，运行软件。



(a) 下载过程介绍，如下图所示。

注：在下载过程开始前，请将烧录器用 USB 线连接到电脑上。





第九步：点击下载按钮，下载程序

第八步：确认校验和是否正确

第七步：选择好配置字

第十一步：下载完成后，会提示下载成功

第十步：下载过程中，滚动条会发生变化

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	
00000	0219	0152	0A9E	29C3	211F	310A	3651	3499	1072	1289	39F
00010	32B0	2CF0	21B8	24B6	3DBE	29B5	2463	245B	2A5C	2DA1	387
00020	25DD	2222	37C0	362E	2E64	2DE0	39BF	3D25	2D21	29F5	245
00030	3647	2155	1B3A	0F77	173C	09F7	1EE0	0C64	184E	01F6	081
00040	13CE	0E4F	1E23	1420	3757	0B59	2AFE	1168	1B9C	13B5	19E
00050	0014	298C	06B3	3662	1270	258B	1BE8	38FA	0C1B	3255	10E
00060	2AFF	030D	3CF5	1701	16DD	090C	3705	16B3	21AD	1A3E	094
00070	2E60	09CC	0B1C	0E9B	1B8D	3224	1540	327D	1C12	3E17	3CE
00080	2418	1DB8	2EDF	0CE7	0A89	1949	2830	0717	14B0	0BEC	2BA

(b) 下载过程中烧录器红黄灯全部点亮，下载完成全部熄灭。

(c) 使用 33 版本上位机软件，在实现最新固件自动更新的同时，会在烧写器显示屏上滚动显示



校验和以及所选芯片的型号名称。

下图以 HS2300-P 为例，烧写程序校验和为 7016-516E。该图为滚动显示过程中所捕捉。



下载成功后显示屏滚动显示顺序为：校验和一芯片型号（示例中将完整滚动显示 7016-516E-HS2300-P）。

(d) 在进行滚动码设置后，所设置滚动码也将在显示屏滚动显示。此时显示顺序为校验和一滚动码一芯片型号。下图以 HS2300-P 为例，烧写程序校验和为 7016-516E。

滚动码设置如下：



滚动码设置完成后点击打开，并确定。



下载成功后显示屏滚动显示顺序为：校验和一滚动码—芯片型号（示例中将完整滚动显示7016-516E-123456-HS2300-P）。下图为滚动显示过程中所捕捉。



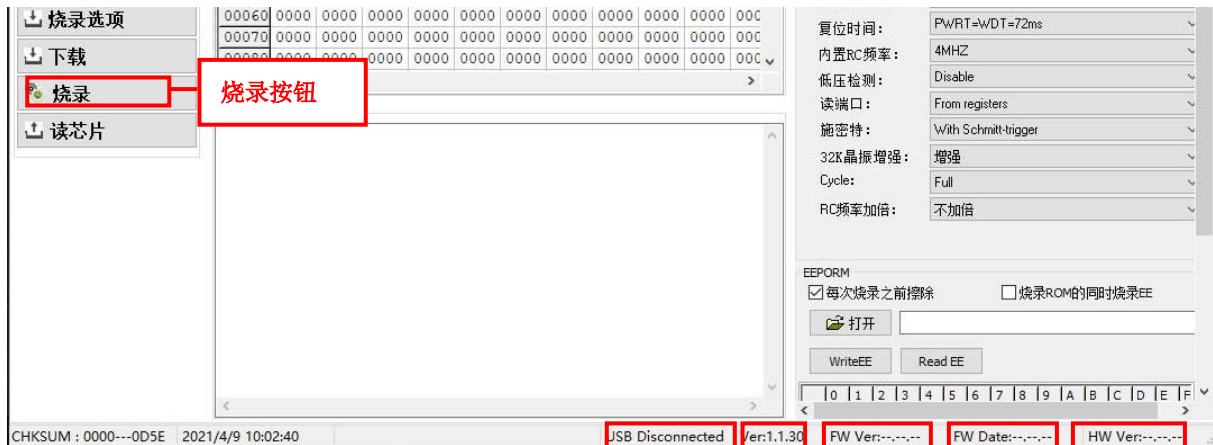
五. 烧录方式

1、硬件方式



按压图中开关（Key）进行烧录

2、软件方式



USB Connected 连接成功
USB Disconnected 连接失败

USB 是否
连接成功

烧写
软件版本

烧录器
固件版本

烧录器固件
生成日期

烧录器
硬件版本

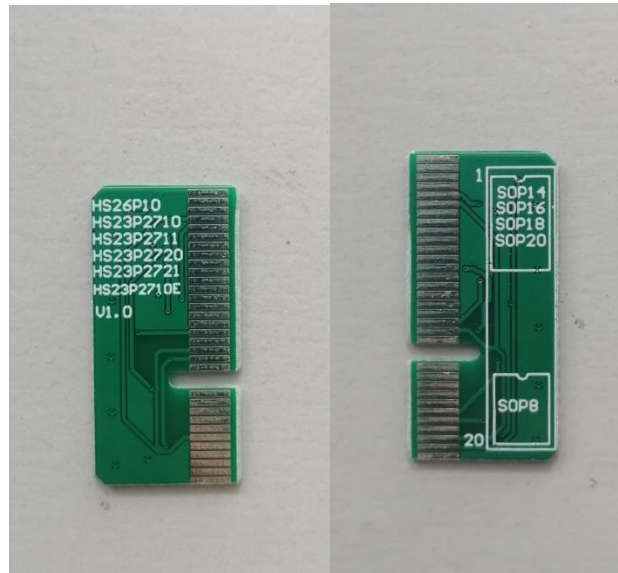
- 1、使用 1.1.24 及以上版本软件
- 2、确保上位机与烧录器连接状态为 USB Connected
- 3、单击烧录按钮，烧录器亮黄灯，等待烧录结束，烧录成功亮绿灯，烧录失败亮红灯



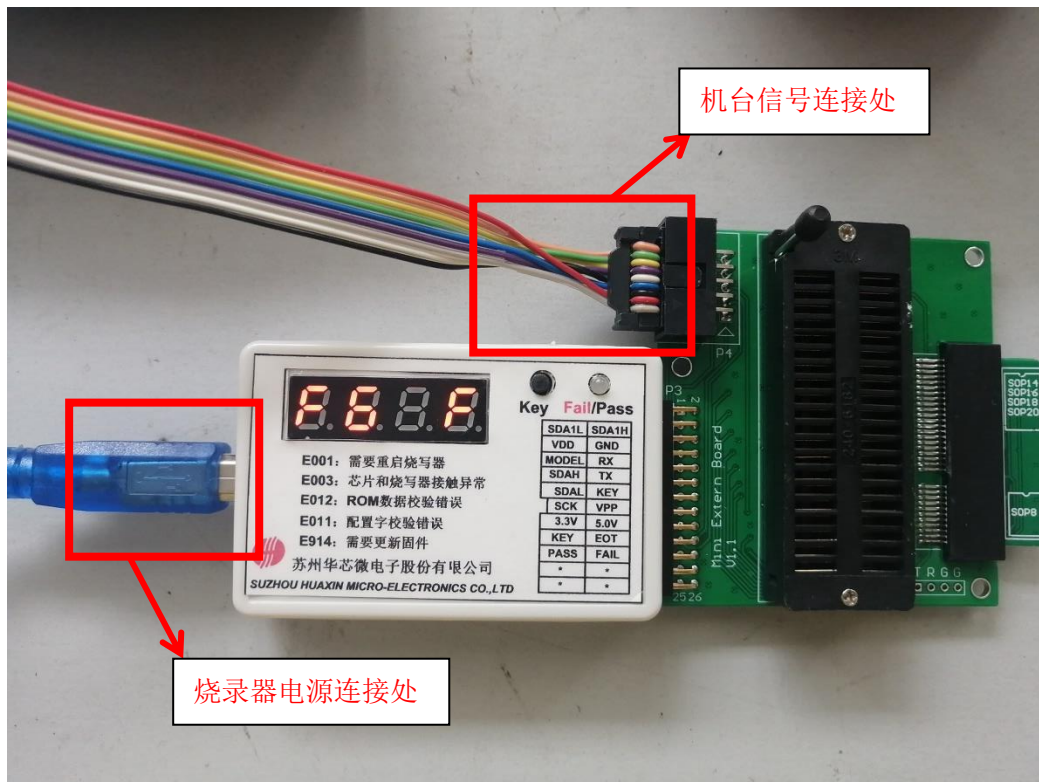
六. 迷你机台烧录器与机台连接方式

示例中所使用转接卡为 HS26P10

转接卡如下所示:



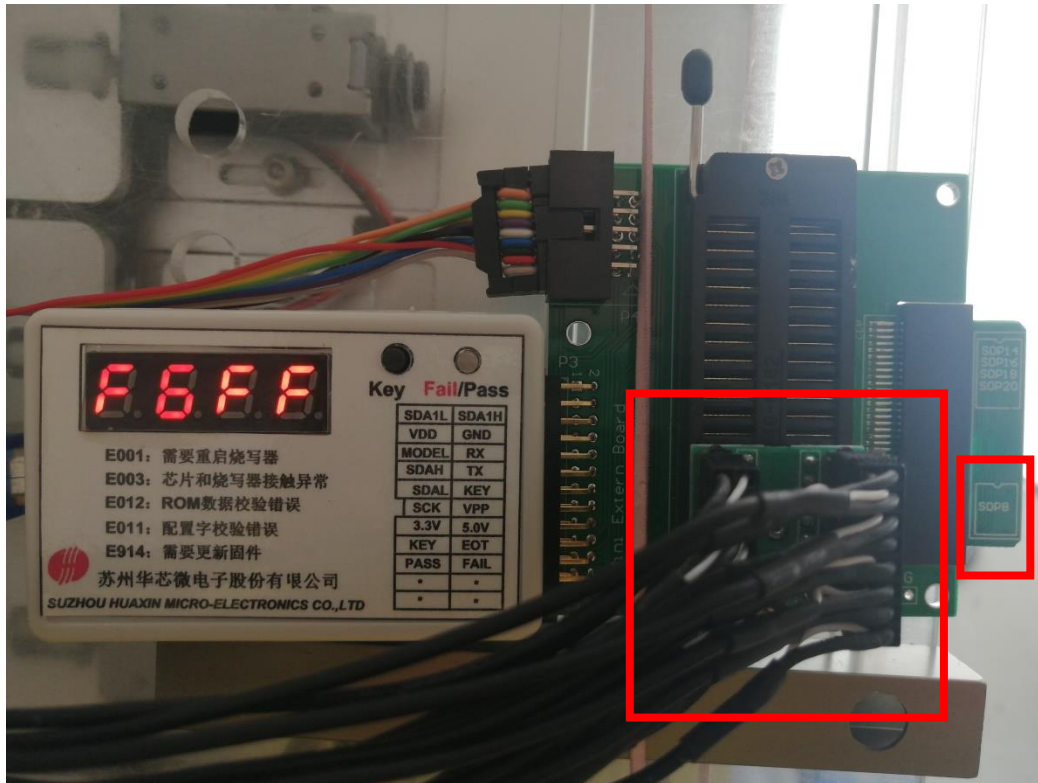
新迷你机台烧录器与机台连接连接如下





确定所烧录芯片的脚位后，根据转接卡不同脚位所对应的位置进行连接

下图为 HS26P10 SOP8 进行烧录的连接方式：

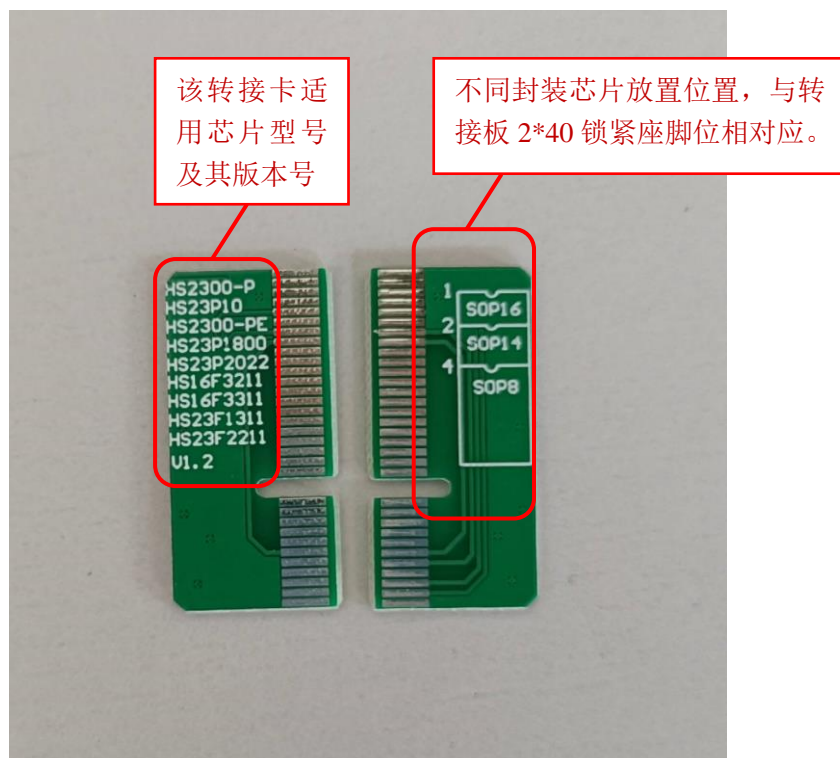
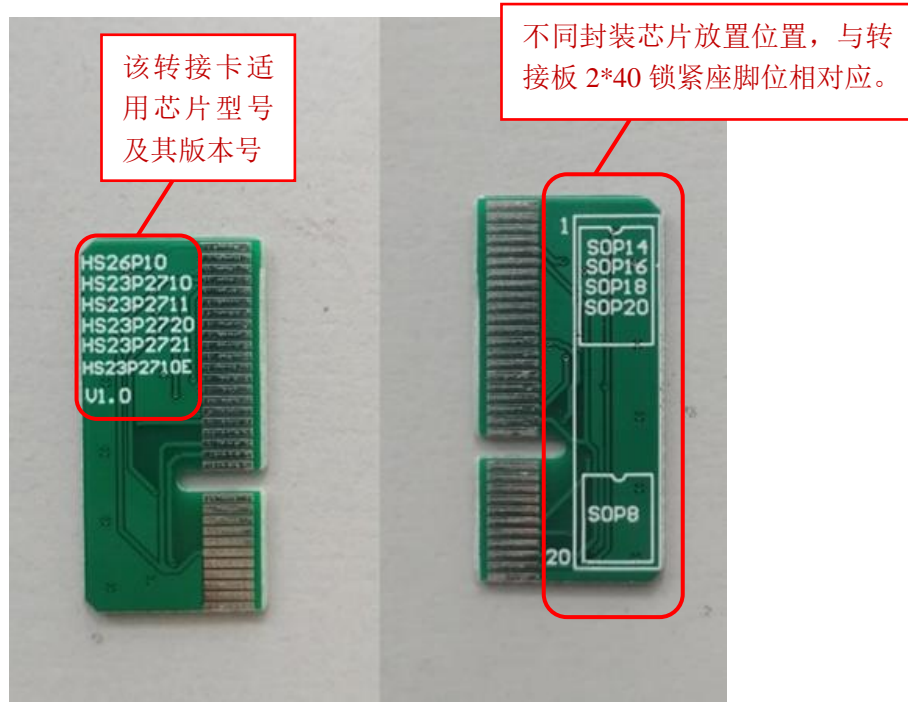


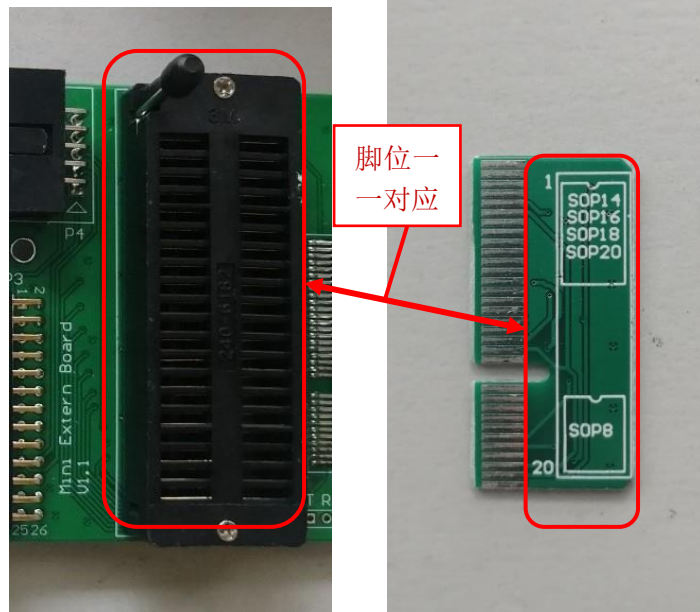


七. 迷你机台烧录器芯片放置方式

本章节对于不同芯片如何放置进行详细介绍，示例中使用芯片为 HS2300-P 及 HS26P10。

1、转接卡外观说明：

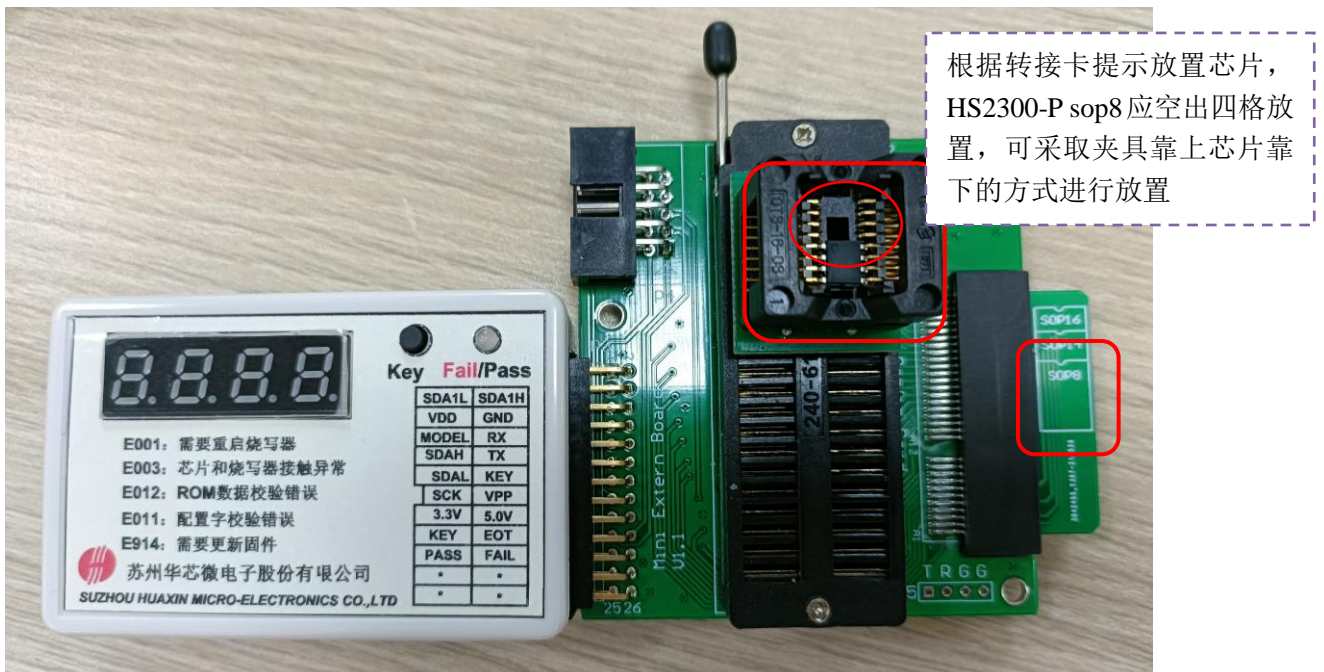




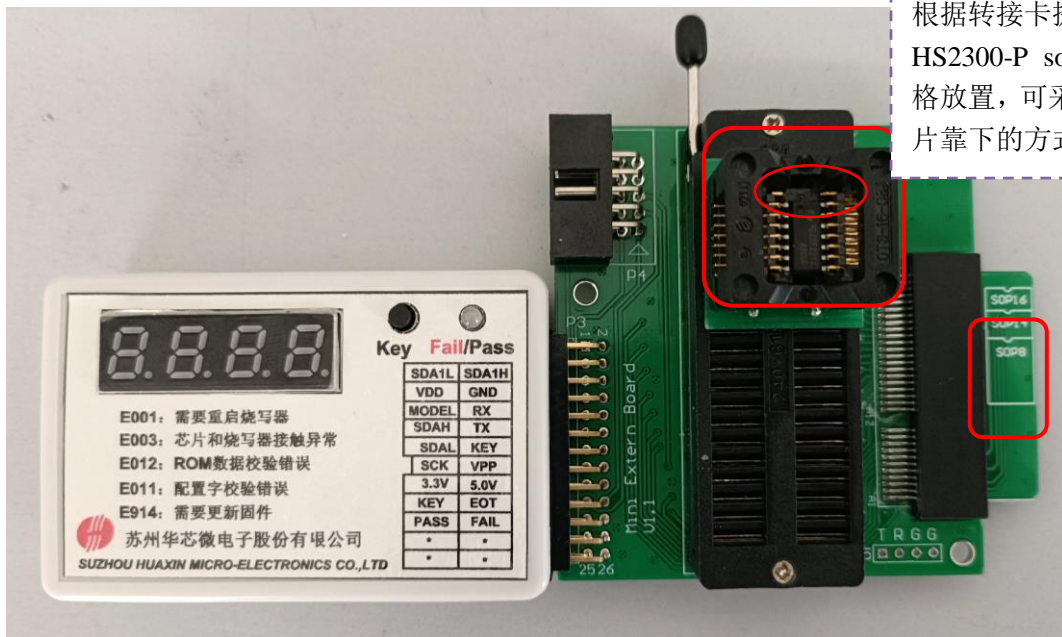
2、芯片放置说明：

HS2300-P 不同封装脚位放置说明：

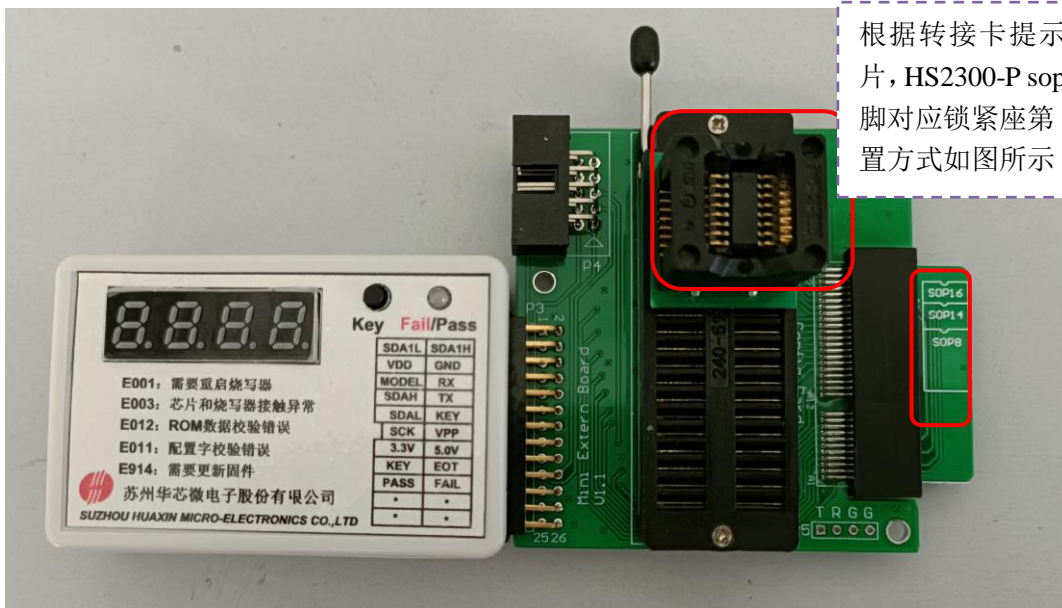
SOP8 封装放置



SOP14 封装放置

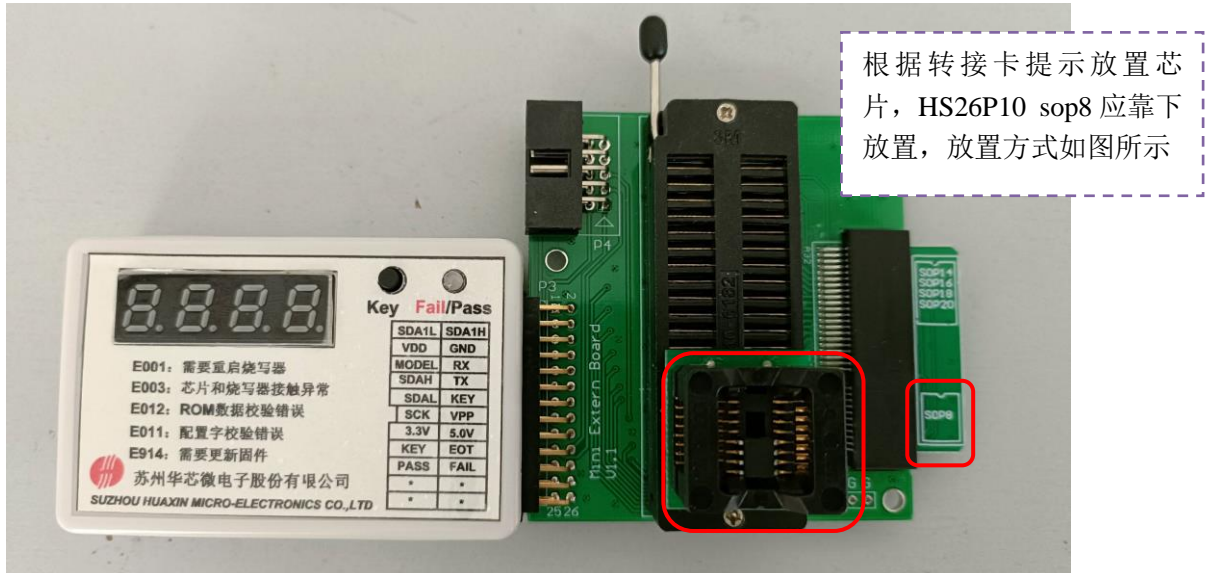


SOP16 封装放置

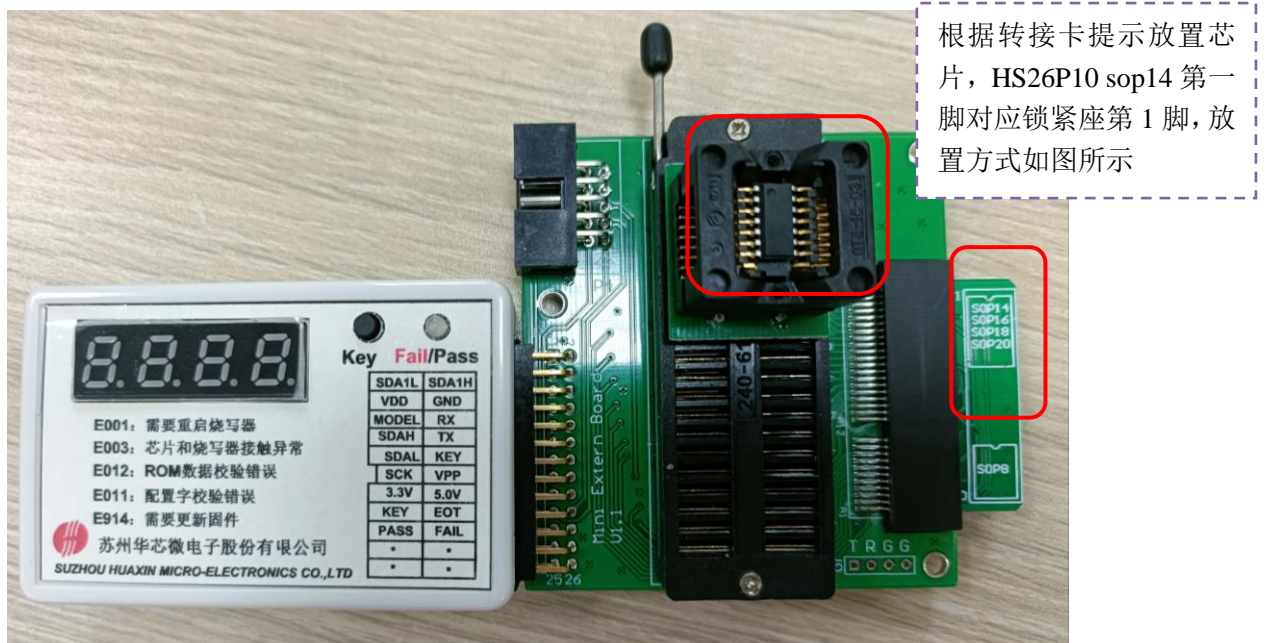


HS26P10 不同封装脚位放置说明:

SOP8 封装放置

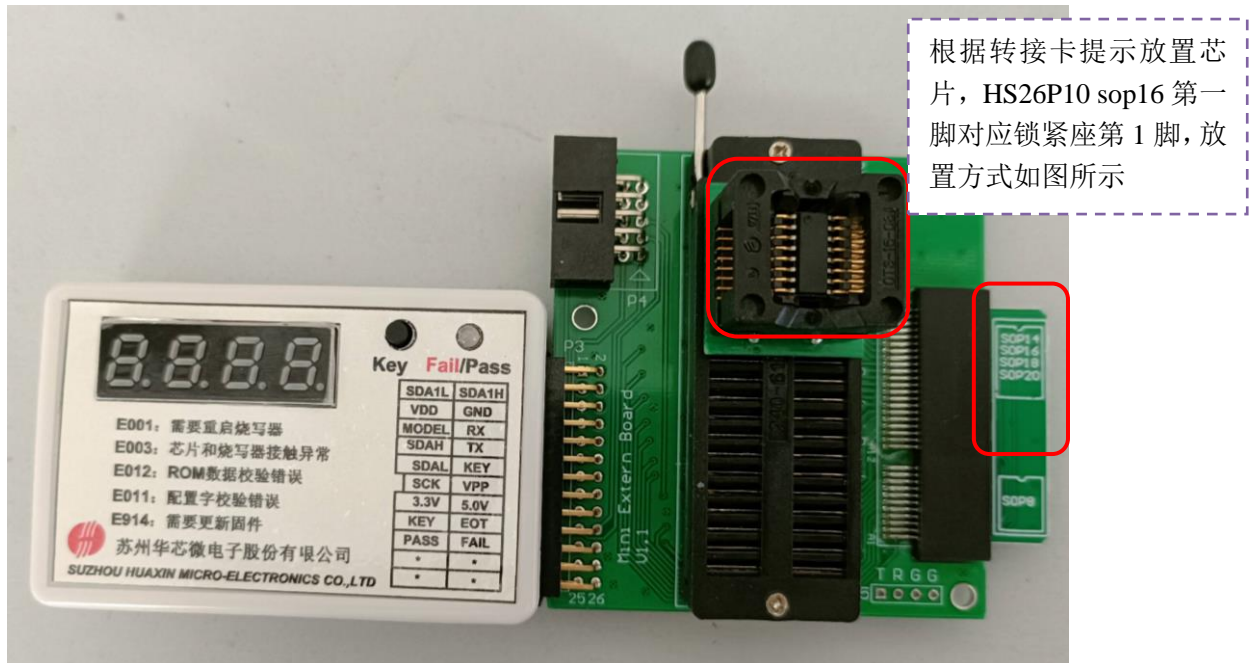


SOP14 封装放置





SOP16 封装放置



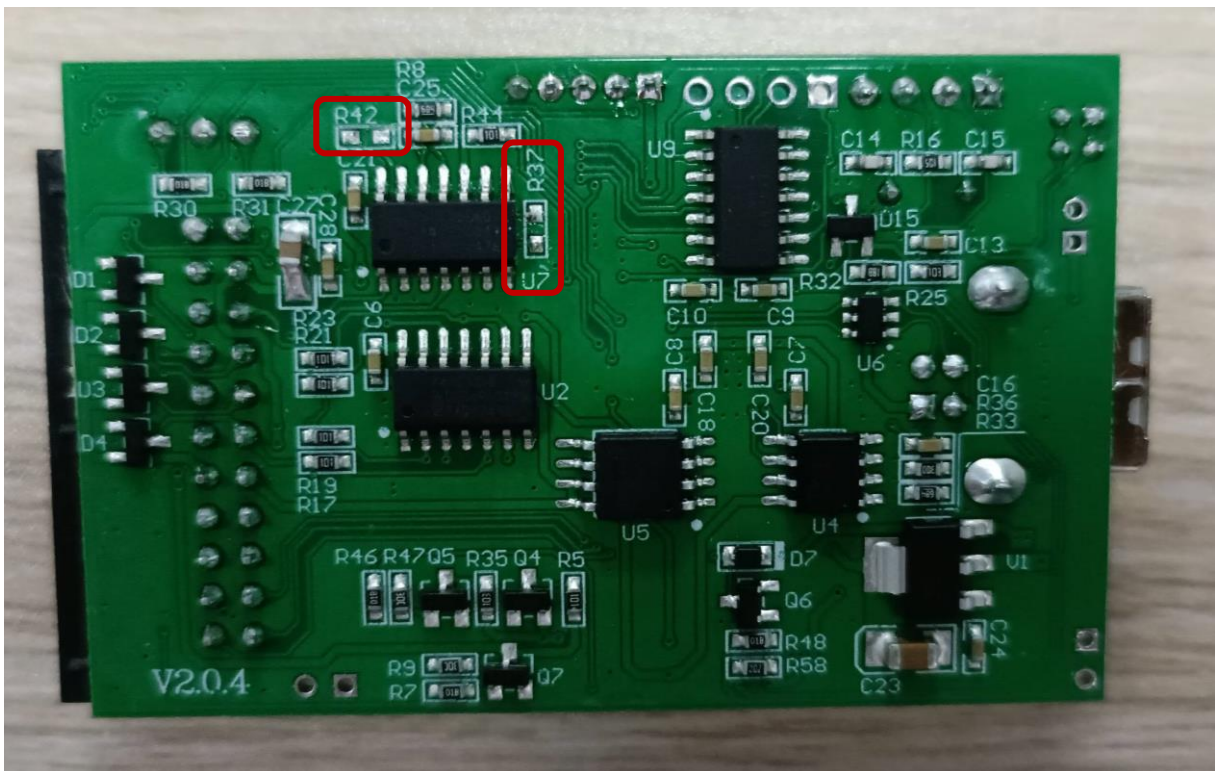
对于其他芯片不同封装的放置方式，均以转接卡提示为准。可参考以上 HS2300-P 以及 HS26P10 不同封装芯片的放置方式。



附录：补充说明

迷你机台烧录器：

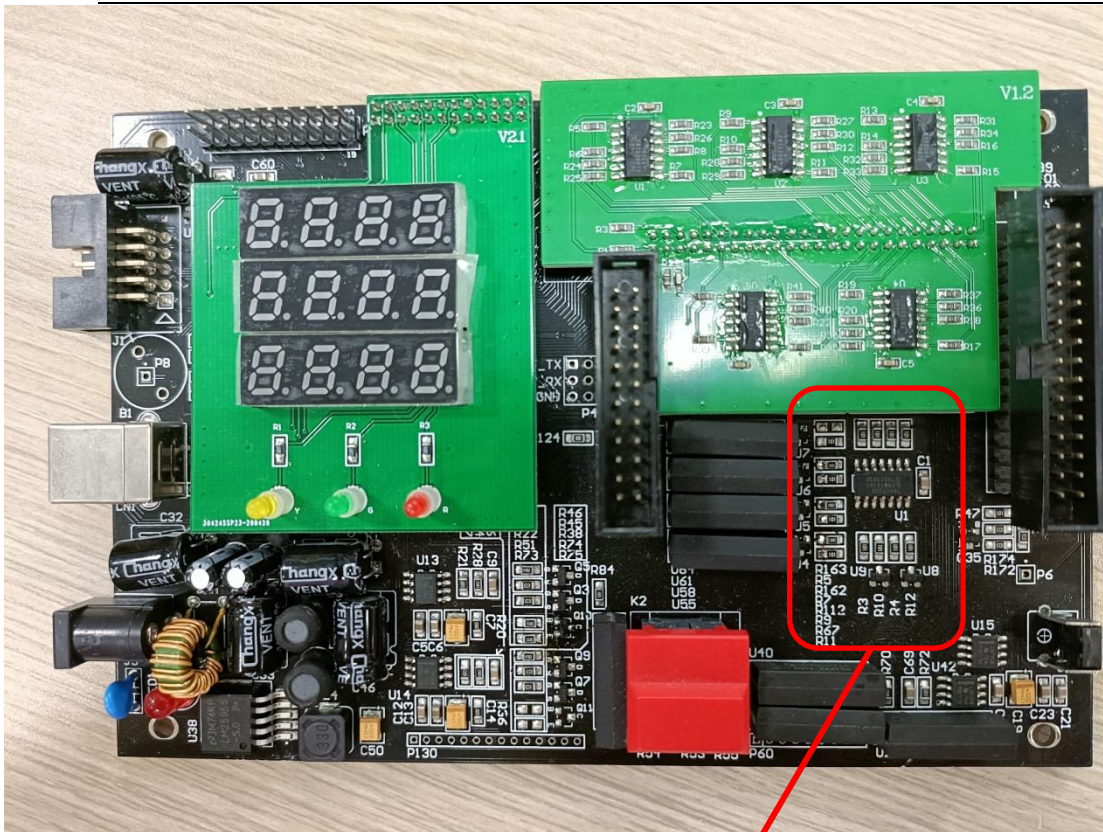
该说明主要针对于 2021 年 08 月之前收到的本迷你机台烧录器，应对烧录器主板进行检查，并去除 R37、R42 两个电阻，具体位置如下图标注。



6620 系列烧录器相关说明：

该说明主要针对于 HS23P6625、HS23P6622、HS23P6620、HS23P6621、HS23P6603 芯片。对于该系列芯片进行烧录时，烧录器应做以下调整。

对于三代烧录器，应将烧录器左端红框所圈位置的 R112 进行拆除，具体位置如下所示：



将该处放大

R112 所对应电阻就是上方所圈位置



对于 mini 机台烧录器，应将烧录器左端红框所圈位置的 R3 进行拆除，具体位置如下所示：

